

Bruxelles, 21 noiembrie 2018
(OR. en)

14559/18
ADD 1

ENV 797
MI 870
DELA CT 153

NOTĂ DE ÎNȘOȚIRE

Sursă:	Secretar general al Comisiei Europene, sub semnătura dlui Jordi AYET PUIGARNAU, director
Data primirii:	19 noiembrie 2018
Destinatar:	DI Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Secretarul General al Consiliului Uniunii Europene
Nr. doc. Csie:	C(2018) 7499 final - Annex
Subiect:	ANEXĂ la Directiva delegată a Comisiei de modificare, în scopul adaptării la progresul științific și tehnic, a anexei III la Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește o derogare pentru plumbul din sudurile pentru realizarea unei conexiuni electrice viabile între purtător și substratul semiconductorului în carcusele de circuite integrate de tip „flip chip”

În anexă, se pune la dispoziția delegațiilor documentul C(2018) 7499 final - Annex.

Anexă: C(2018) 7499 final - Annex

Bruxelles, 16.11.2018
C(2018) 7499 final

ANNEX

ANEXĂ

la

Directiva delegată a Comisiei

**de modificare, în scopul adaptării la progresul științific și tehnic, a anexei III la
Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește o
derogare pentru plumbul din sudurile pentru realizarea unei conexiuni electrice viabile
între purtător și substratul semiconductorului în carcusele de circuite integrate de tip
„flip chip”**

ANEXĂ

În anexa III, punctul 15 se înlocuiește cu următorul text:

„15	Plumbul din sudurile pentru realizarea unei conexiuni electrice viabile între purtător și substratul semiconductorului în carcassele de circuite integrate de tip „flip chip”	Se aplică pentru categoriile 8, 9 și 11 și expiră la: – 21 iulie 2021 pentru categoriile 8 și 9, cu excepția dispozitivelor medicale de diagnosticare <i>in vitro</i> și a instrumentelor industriale de monitorizare și control; – 21 iulie 2023 pentru dispozitivele medicale de diagnosticare <i>in vitro</i> din categoria 8; – 21 iulie 2024 pentru instrumentele industriale de monitorizare și control din categoria 9 și pentru categoria 11.
15(a)	Plumbul din sudurile pentru realizarea unei conexiuni electrice viabile între purtător și substratul semiconductorului în carcassele de circuite integrate de tip „flip chip”, dacă este îndeplinit cel puțin unul dintre următoarele criterii: – există un nod tehnologic semiconductor de 90 nm sau mai mare; – există un substrat de 300 mm² sau mai mare în orice nod tehnologic semiconductor; – există carcasse suprapuse cu substrat de 300 mm² sau mai mare sau substraturi (<i>interposers</i>) din siliciu de 300 mm² sau mai mari.	Se aplică pentru categoriile 1-7 și 10 și expiră la 21 iulie 2021.”